股票代码：600460　　股票简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

签署日期：二〇二〇年七月

发行对象/认购人	
发行股份购买资产交易对方	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
募集配套资金认购方	不超过35名符合条件的特定投资者

上市公司及董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺函

一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺；本公司/本人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、本公司/本人向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、文件均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、本公司/本人为本次交易所出具的确认、说明或承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司/本人将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

五、本公司/本人对所提供的信息、资料、文件以及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。

交易对方关于提供信息真实、准确、完整的承诺函

本次发行股份购买资产的交易对方承诺：

一、本公司将及时向上市公司提供与本次交易有关的信息，并保证本公司所提供的上述信息真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

二、本公司保证所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

三、若因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；

释义

在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

本预案	指	《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本次交易、本次重组	指	杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的行为
士兰微、上市公司、公司、本公司	指	杭州士兰微电子股份有限公司
标的公司	指	杭州集华投资有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司
交易对方、大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
华芯投资	指	华芯投资管理有限责任公司
交易双方	指	士兰微、大基金
集华投资	指	杭州集华投资有限公司
士兰集昕	指	杭州士兰集昕微电子有限公司
标的资产、拟购买资产、交易标的、标的股权	指	大基金所持的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权
发行股份购买资产的定价基准日	指	士兰微第七届董事会第十二次会议决议公告日，即2020年7月25日
审计/评估基准日	指	2020年7月31日
士兰控股	指	杭州士兰控股有限公司
士兰集成	指	杭州士兰集成电路有限公司
士兰明芯	指	杭州士兰明芯科技有限公司
成都士兰	指	成都士兰半导体制造有限公司
美卡乐	指	杭州美卡乐光电有限公司
深兰微	指	深圳市深兰微电子有限公司
士兰光电	指	杭州士兰光电技术有限公司
士兰电子	指	杭州士兰电子有限公司
士腾科技	指	杭州士腾科技有限公司
友旺科技	指	杭州友旺科技有限公司
交割日	指	标的公司就本次重组完成工商变更登记手续，将标的资产登记在士兰微名下之日
重组报告书	指	杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
《发行股份购买资产协议》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

集成电路、IC	指	Integrated Circuit，简称为IC，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
功率半导体器件	指	Power Electronic Device，又称为电力电子器件。主要用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件
分立器件	指	只具备单一功能的电路，包括电容、电阻、晶体管和熔断丝等
晶圆	指	单晶硅圆片，由普通硅沙拉制提炼而成，是最常用的半导体材料
IDM	指	Integrated Design & Manufacture，设计与制造一体模式
MEMS	指	Micro-Electro-Mechanical Systems，微机电控制系统。是集微型结构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统
LED	指	Lighting Emitting Diode，发光二极管。是一种半导体固体发光器件，利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光
MOSFET	指	MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor，金属-氧化物半导体场效应晶体管，简称金氧半场效晶体管。是一种广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管
FRD	指	Fast Recovery Diode，快恢复二极管。是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管，主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中，作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管，是由BJT和MOS组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点
BCD工艺	指	将硅平面工艺用于功率集成，可以将双极Bipolar、CMOS和DMOS器件同时集成到单芯片上的工艺技术
BiCMOS工艺	指	把双极性晶体管和CMOS器件同时集成到单芯片上的新型工艺技术
IHS	指	IHSmarkit，一家提供全球商业资讯服务的市场研究公司

本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

本预案中涉及标的公司的财务数据、评估数据尚未经具有证券业务资格的会计师事务所、资产评估机构进行正式审计和评估，提醒投资者谨慎使用。经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露，最终审计、评估结果可能与本预案相关数据存在一定差异，特提请投资者注意。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。

（一）发行股份购买资产

本次交易前，上市公司直接持有集华投资51.22%的股权，直接持有士兰集昕6.29%的股权。集华投资为士兰集昕的第一大股东，其直接持有士兰集昕47.25%的股权。

上市公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。

本次交易完成后，上市公司将直接持有集华投资70.73%的股权，直接持有士兰集昕26.67%的股权。集华投资对士兰集昕的持股比例保持不变。上市公司将通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.74%的股权。

本次交易标的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经由交易双方协商并另行签署补充协议予以确定。

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日，即第七届董事会第十二次会议决议公告日。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%，即13.62元/股。

本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为士兰控股，实际控制人仍为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人，本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

（二）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过130,000万元且不超过拟购买资产交易价格的100%，同时，发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易上市公司向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

二、发行股份购买资产

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

（二）发行方式及发行对象

本次交易发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行股票；发行股份对象为交易对方国家集成电路产业投资基金股份有限公司。

（三）标的资产的定价原则及交易价格

本次交易标的资产的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经由交易双方协商并另行签署补充协议予以确定。评估基准日暂定为2020年7月31日。

（四）对价支付方式

公司拟全部通过发行股份方式向交易对方支付交易对价。

（五）定价基准日和发行股份的价格

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
定价基准日前20个交易日	15.60	14.04
定价基准日前60个交易日	15.14	13.62
定价基准日前120个交易日	16.65	14.98

交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即为13.62元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。

（六）发行股份的数量

本次交易发行股份购买资产中交易对方获得的上市公司新增股份数量以交易双方协商确定的标的资产的最终定价除以发行价格计算。发行数量精确至股，不足一股的部分作舍去处理。

（七）调价机制

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将根据中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。

除上述除息、除权事项导致的发行价格调整外，本次交易暂不设置发行价格调整机制。

（八）股份锁定期

本次交易完成后，交易对方认购的士兰微新增股份的限售期将按照中国证监会相关规定由交易双方另行约定。

（九）交割后标的公司权益归属

本次交易完成后，交易双方按本次交易完成后的股权比例享有标的公司的权益。

（十）业绩补偿承诺

本次交易不设置业绩补偿承诺。

三、募集配套资金

（一）发行股份的种类、面值、上市地点

本次募集配套资金的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。

（二）发行方式及发行对象

本次交易发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行；发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

（三）定价基准日和发行股份的价格

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（四）发行股份的数量

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过130,000万元且不超过拟购买资产交易价格的100%，同时，发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

最终发行的股份数量，将在募集配套资金获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（五）股份锁定安排

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（六）募集配套资金用途

本次交易发行股份募集配套资金用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

三、会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具有构成重大资产重组可能性的议案》

根据《重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。"《重组管理办法》第十五条规定"本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资；……上述资产交易实质上构成购买、出售资产，且按照本办法规定的标准计算的相关比例达到50%以上的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。"

公司于2019年8月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目（即"8吋芯片生产线二期项目"）的议案》，同意士兰微对集华投资增资3.15亿元人民币。2019年12月，集华投资完成了上述增资的股权变更工商登记事项。本次交易需与前次增资行为合并计算。

根据上市公司和标的公司2019年审计报告，相关财务数据占比计算的结果如下：

单位：万元

项目	标的	计算	资产总额	资产净额	营业收入
财务指标	集华投资	a	70,226.64	70,220.65	0
	士兰集昕	b	266,358.63	129,712.04	46,670.39
	合计	c=a+b	336,585.27	199,932.69	46,670.39
标的公司少数股权对应财务指标	集华投资	d=a*19.51%	13,701.22	13,700.05	0
	士兰集昕	e=b*20.38%	54,283.89	26,435.31	9,511.42
	合计	f=d+e	67,985.11	40,135.36	9,511.42
士兰微财务指标		g	891,326.02	337,897.84	311,057.38
财务指标占比		h=f/g	7.63%	11.88%	3.06%

特别提示：鉴于本次交易标的预估值及交易对价尚未确定，上述计算未考虑本次交易作价的影响，后续待双方确认交易价格后，将补充计算指标。

虽然相关财务数据占比计算的结果未达到《重组管理办法》第十二条的规定，但本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，并且上市公司过去12个月内存在向集华投资增资3.15亿元的事项需要合并计算。因此，本次交易具有构成重大资产重组的可能性。同时，本次交易采取发行股份购买资产的方式，需通过并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

五、本次交易标的资产

本次交易涉及的标的资产为集华投资和士兰集昕的股权。

（一）集华投资

集华投资为一家成立于2019年7月24日的有限责任公司，主营业务为集成电路芯片的设计、生产、销售和提供相关技术服务。截至本预案出具日，集华投资的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	杭州士兰控股有限公司	513,503,234	39.14
2	中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	2.37
3	厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	1.62
4	中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	20,220,549	1.54
5	香港中央结算有限公司	14,577,230	1.11
6	中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	14,505,315	1.11
7	陈向东	12,349,896	0.94
8	江苏新潮科技集团有限公司	11,004,296	0.84
9	范伟宏	10,613,866	0.81
10	国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,236,619	0.70

三、前10大流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司流通股股本比例（%）
1	杭州士兰控股有限公司	513,503,234	39.14
2	中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	2.37
3	厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	1.62
4	中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	20,220,549	1.54
5	香港中央结算有限公司	14,577,230	1.11
6	中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	14,505,315	1.11
7	陈向东	12,349,896	0.94
8	江苏新潮科技集团有限公司	11,004,296	0.84
9	范伟宏	10,613,866	0.81
10	国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,236,619	0.70

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2020年7月25日

证券代码：600460　　证券简称：士兰微　　编号：临2020-039

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"士兰微"）第七届董事会第十二次会议于2020年7月24日以现场结合通讯的方式召开，本次董事会已于2020年7月18日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟通过发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"大基金"）持有的杭州集华投资有限公司（以下简称"集华投资"）19.51%的股权以及杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称"士兰集昕"）20.38%的股权，同时上市公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，公司经过对实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次交易符合前述法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定，符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

（一）本次交易的整体方案

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。

1、发行股份购买资产

杭州士兰微电子股份有限公司拟通过发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的杭州集华投资有限公司19.51%的股权以及杭州士兰集昕微电子有限公司20.38%的股权。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、募集配套资金

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过130,000万元且不超过拟购买资产交易价格的100%，同时，发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易上市公司向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）本次交易的具体方案

1、发行股份购买资产

（1）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次交易发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行股票；发行股份对象为交易对方国家集成电路产业投资基金股份有限公司。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（3）标的资产的定价原则及交易价格

本次交易标的资产的交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经由交易双方协商并另行签署补充协议予以确定。评估基准日暂定为2020年7月31日。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（4）对价支付方式

公司拟全部通过发行股份方式向交易对方支付交易对价。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（5）定价基准日和发行股份的价格

根据《重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下：

交易均价类型	交易均价（元/股）	交易均价的90%（元/股）
定价基准日前20个交易日	15.60	14.04
定价基准日前60个交易日	15.14	13.62
定价基准日前120个交易日	16.65	14.98

交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%，即为13.62元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。

（六）发行股份的数量

本次交易发行股份购买资产中交易对方获得的上市公司新增股份数量以交易双方协商确定的标的资产的最终定价除以发行价格计算。发行数量精确至股，不足一股的部分作舍去处理。

（七）调价机制

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将根据中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。

除上述除息、除权事项导致的发行价格调整外，本次交易暂不设置发行价格调整机制。

（八）股份锁定期

本次交易完成后，交易对方认购的士兰微新增股份的限售期，将按照中国证监会相关规定由交易双方另行约定。

（九）交割后标的公司权益归属

本次交易完成后，交易双方按本次交易完成后的股权比例享有标的公司的权益。

（十）业绩补偿承诺

本次交易不设置业绩补偿承诺。

（十一）募集配套资金

（1）发行股份的种类、面值、上市地点

本次募集配套资金的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（2）发行方式及发行对象

本次交易发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行；发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（3）定价基准日和发行股份的价格

本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（4）发行股份的数量

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过130,000万元且不超过拟购买资产交易价格的100%，同时，发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

最终发行的股份数量，将在募集配套资金获得中国证监会核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

（5）股份锁定安排

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自股份上市之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生配股、送股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（6）募集配套资金用途

本次交易发行股份募集配套资金用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务。

关联董事纪路先生回避表决。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。

三、会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金具有构成重大资产重组可能性的议案》

根据《重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。"《重组管理办法》第十五条规定"本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资；……上述资产交易实质上构成购买、出售资产，且按照本办法规定的标准计算的相关比例达到50%以上的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。"

公司于2019年8月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目（即"8吋芯片生产线二期项目"）的议案》，同意士兰微对集华投资增资3.15亿元人民币。2019年12月，集华投资完成了上述增资的股权变更工商登记事项。本次交易需与前次增资行为合并计算。

根据上市公司和标的公司2019年审计报告，相关财务数据占比计算的结果如下：

单位：万元

项目	标的	计算	资产总额	资产净额	营业收入
财务指标	集华投资	a	70,226.64	70,220.65	0
	士兰集昕	b	266,358.63	129,712.04	46,670.39
	合计	c=a+b	336,585.27	199,932.69	46,670.39
标的公司少数股权对应财务指标	集华投资	d=a*19.51%	13,701.22	13,700.05	0
	士兰集昕	e=b*20.38%	54,283.89	26,435.31	9,511.42
	合计	f=d+e	67,985.11	40,135.36	9,511.42
士兰微财务指标		g	891,326.02	337,897.84	311,057.38
财务指标占比		h=f/g	7.63%	11.88%	3.06%

特别提示：鉴于本次交易标的预估值及交易对价尚未确定，上述计算未考虑本次交易作价的影响，后续待双方确认交易价格后，将补充计算指标。

虽然相关财务数据占比计算的结果未达到《重组管理办法》第十二条的规定，但本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，并且上市公司过去12个月内存在向集华投资增资3.15亿元的事项需要合并计算。因此，本次交易具有构成重大资产重组的可能性。同时，本次交易采取发行股份购买资产的方式，需通过并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

四、本次交易具有构成重大资产重组的可能性

根据《重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。已按照规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。"《重组管理办法》第十五条规定"本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）与他人新设企业、对已设立的企业增资或者减资；……上述资产交易实质上构成购买、出售资产，且按照本办法规定的标准计算的相关比例达到50%以上的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。"

公司于2019年8月26日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目（即"8吋芯片生产线二期项目"）的议案》，同意士兰微对集华投资增资3.15亿元人民币。2019年12月，集华投资完成了上述增资的股权变更工商登记事项。本次交易需与前次增资行为合并计算。

根据上市公司和标的公司2019年审计报告，相关财务数据占比计算的结果如下：

单位：万元

项目	标的	计算	资产总额	资产净额	营业收入
财务指标	集华投资	a	70,226.64	70,220.65	0
	士兰集昕	b	266,358.63	129,712.04	46,670.39
	合计	c=a+b	336,585.27	199,932.69	46,670.39
标的公司少数股权对应财务指标	集华投资	d=a*19.51%	13,701.22	13,700.05	0
	士兰集昕	e=b*20.38%	54,283.89	26,435.31	9,511.42
	合计	f=d+e	67,985.11	40,135.36	9,511.42
士兰微财务指标		g	891,326.02	337,897.84	311,057.38
财务指标占比		h=f/g	7.63%	11.88%	3.06%

特别提示：鉴于本次交易标的预估值及交易对价尚未确定，上述计算未考虑本次交易作价的影响，后续待双方确认交易价格后，将补充计算指标。

虽然相关财务数据占比计算的结果未达到《重组管理办法》第十二条的规定，但本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，并且上市公司过去12个月内存在向集华投资增资3.15亿元的事项需要合并计算。因此，本次交易具有构成重大资产重组的可能性。同时，本次交易采取发行股份购买资产的方式，需通过并购重组委的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。

五、本次交易标的资产

本次交易涉及的标的资产为集华投资和士兰集昕的股权。

（一）集华投资

集华投资为一家成立于2019年7月24日的有限责任公司，主营业务为集成电路芯片的设计、生产、销售和提供相关技术服务。截至本预案出具日，集华投资的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	杭州士兰控股有限公司	513,503,234	39.14
2	中央汇金资产管理有限责任公司	31,071,900	2.37
3	厦门半导体投资集团有限公司	21,276,595	1.62
4	中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	20,220,549	1.54
5	香港中央结算有限公司	14,577,230	1.11
6	中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	14,505,315	1.11
7	陈向东	12,349,896	0.94
8	江苏新潮科技集团有限公司	11,004,296	0.84
9	范伟宏	10,613,866	0.81
10	国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导